

Lead-Free/Tg 150/Low CTE

特性 (Feature)

- 无铅 Tg>150°C
Lead-free DSC Tg>150°C
- 优良的耐热性
Excellent thermal reliability
- 低的Z轴热膨胀系数
Low Z-CTE
- 良好的耐CAF性能
Anti-CAF capability

应用 (Application)

- 电脑及笔记本电脑
Computer and NB
- 仪器仪表
Instruments
- 消费电子
Consumer electronics
- 汽车电子
Automotive electronics

板材性能 (Laminate Properties)

Test Item 测试项目		Test Method (IPC-TM-650) 测试方法	Test Condition 处理条件		Unit 单位	Typical Value 典型值
Thermal 热性能	Thermal Stress 热应力	2.4.13.1	Float 288 °C / Unetched		Sec	≥240
	Glass Transition (Tg) 玻璃化转变温度	2.4.25	DSC		°C	157
	CTE / Z-Axis Expansion Z-轴热膨胀系数	2.4.24	Alpha 1		ppm/°C	37
			Alpha 2			230
			50 - 260 °C		%	2.8
	X/Y CTE X/Y-轴热膨胀系数	2.4.24	40 °C - 125 °C		ppm/°C	12/15
	T-260	2.4.24.1	TMA		min	> 60
	T-288	2.4.24.1	TMA		min	> 30
TD(5% weight loss) Flammability 燃烧性	2.4.24.6 UL94	TGA E-24/125		°C Rating	352 V-0	
Electrical 电性能	Surface Resistivity 表面电阻率	2.5.17.1	C-96/35/90		MΩ	4.6×10 ⁸
	Volume Resistivity 体积电阻率	2.5.17.1	C-96/35/90		MΩ-cm	5.4×10 ⁹
	Dielectric Breakdown 击穿电压	2.5.6	D-48/50+D0.5/23		kV	≥45
	Dielectric Constant 介电常数	2.5.5.9	Etched (RC50%)	@ 1 MHz	—	4.8
				@ 1 GHz		4.6
	Loss Tangent 介质损耗	2.5.5.9	Etched (RC50%)	@ 1 MHz	—	0.015
				@ 1 GHz		0.016
	CTI 相对漏电起痕指数	IEC60112	Etched/0.1% NH ₄ CL		V	≥175
Arc Resistance 耐电弧性	2.5.1	D-48/50+D-0.5/23		Sec	127	
Mechanical 机械性能	Peel Strength (1 oz.) 铜箔剥离强度	2.4.8	A		N/mm	--
			Float 288 °C / 10 Sec			1.45
	Flexural Strength 弯曲强度	2.4.4	Lengthwise		N/mm ²	540
			Crosswise			480
	Water Absorption 吸水率	2.6.2.1	D-24/23		%	0.09

Remarks:
- Typical Values for reference only.
- Standard Values according to IPC-4101E /99/101
- Typical Value of Specimen thickness is 1.6mm (8*7628)

注:
- 典型值只供参考
- 规格值参照 IPC-4101E//99/101
- 样品的厚度为 1.6mm ((#7628*8)

